

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临2026-009

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2025年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日上午11:00-12:00通过价值在线路演中心（网址：<https://www.ir-online.cn/>）以网络文字互动的方式召开了2025年度业绩暨现金分红说明会，针对公司2025年度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2026年3月3日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：临2026-008），并向广大投资者征集大家所关心的问题。

公司于2026年3月10日上午11:00-12:00，通过价值在线路演中心（网址：<https://www.ir-online.cn/>）以网络文字互动的方式召开了2025年度业绩暨现金分红说明会。公司董事长兼总经理王蔚先生、董事会秘书兼财务总监段佳国先生、独立董事刘海燕女士出席了本次说明会，针对公司2025年度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题1：请问，1.公司目前产能利用率如何？2026年Q1订单是否饱满？2.公司和豪威集团的合作是否有新进展？豪威在公司的订单占比有无变化？3.从封

测端看，车载CIS和AI眼镜的客户需求有什么变化？4.马来西亚工厂进度如何？预计什么时候能贡献收入？

回答：公司目前产能状态良好，并将通过技术工艺的创新迭代，持续提升生产能力与效率，满足客户与市场需求。

公司专注于集成电路先进封装技术服务，为全球领先的智能传感器先进封装技术开发商与服务商，服务于全球一线芯片设计与知名终端品牌客户。

随着 AI 技术的快速发展，以智能汽车、AI 眼镜、机器人为代表的智能终端应用迅速增长，CIS 作为智能化应用视觉感知系统的核心，也将受益于这一产业发展趋势，公司将充分发挥在 CIS 等智能传感器领域先进封装技术的优势地位，有效把握各相关智能终端应用的市场机遇。

马来西亚生产基地已完成项目土地厂房购买协议签署及资产交割，正处于厂务系统及无尘室装修施工阶段，生产工艺与设备选型、团队组建与培训等工作正在同步开展，预计年底开始打样、试生产。

问题 2：请问，1.封测业务中哪类芯片增速最快，哪类芯片毛利率最高？2.光学器件业务主要提供什么产品给哪类客户？

回答：随着汽车智能化和自动驾驶技术的快速发展，车载摄像头的应用越来越广泛，单车摄像头搭载数量和价值量都在不断提升，带动市场需求快速增长，公司作为全球车规摄像头芯片晶圆级 TSV 封装技术的领先者，通过技术工艺的持续创新、业务规模呈现显著增长态势。

公司光学器件业务涵盖精密光学设计、晶圆级光学制造、精密玻璃加工、光学系统模块集成等技术产品，相关产品主要应用于半导体设备、工业智能、车用智能投射等领域，服务于全球知名品牌客户。

问题 3：请问，1、近期一些芯片领域出现产能偏紧和提价情况，能否介绍下目前公司主营的 CIS 等传感芯片封测领域相关情况。2、公司 25 年毛利率保持增长，从 26 年市场需求及订单情况来看，这一趋势能否延续；公司 25Q4 毛利率主要受什么因素影响。3、公司年报介绍了在堆叠存储、光电领域的技术进展，提到光学技术已成功应用于 CPO、硅基镜头等，目前的商业化进展怎么样。4、公司在功率半导体领域进行了较早的投资布局，面对 AI 算力爆发带来的市场机遇，是否已推出适配产品，获得相关供应链认证。5、如何保护好海外投资及研

发成果不受地缘形势变化影响。

回答：公司专注于集成电路先进封装技术服务，为全球晶圆级TSV封装技术的领先者，重点聚焦CIS为代表的智能传感器市场，封装的产品主要包括CIS芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片、RF芯片等，广泛应用在汽车电子、安防监控及数码（IoT）、AI眼镜、机器人、智能手机等市场领域。

受益于智能汽车、AI眼镜、机器人为代表的智能终端应用快速发展趋势，公司业务规模也呈现快速发展趋势。根据公司2025年年报，由于车规CIS领域封装业务规模与技术领先优势持续提升，公司2025年营收同比增长30.44%，归母扣非净利润同比增长51.60%，经营活动产生的现金流量净额同比增长36.13%。业务规模、盈利与现金流能力快速提升的同时，公司的资产结构优良，资金储备类资产占比近50%，整体资产负债率约11%，为公司未来业务的持续扩展提供了有力保障。展望2026年，以智能汽车为代表的智能终端应用，仍有望呈现快速增长趋势，根据yole数据，2025年全球汽车CIS销售收入将达到25亿美元，2023至2029年的复合增长率达到8.7%。公司将通过技术工艺的持续迭代创新、生产效率的有效提升、全球产能的积极布局，有效把握相关智能终端应用的市场机遇。

随着AI技术的快速发展，AI芯片、自动驾驶、数据中心等新兴应用场景正不断对先进封装技术创新提出新需求，尤其是需要封装技术在有限空间内提供高密度互联方案。公司作为晶圆级TSV封装技术的领先者，未来将继续密切关注产业动态与市场需求，积极推进技术能力创新与市场应用拓展。

近年来为有效应对国际贸易与产业重构发展趋势，更好贴近海外客户需求，巩固提升公司产业地位，公司积极推进全球化发展战略，构建海内、外双驱动循环发展模式，一方面积极聚焦主业发展，不断提升技术创新、产业领先与业务规模，同时有效推进国际先进技术并购、布局全球化生产基地，拓展技术与生产服务能力，并积极通过股权架构设计、协同战略合作伙伴、本土化运营融入、资产证券化等多元化举措，保障海外投资与经营成果。

问题4： 请问，1、目前贵司一季度的产能利用情况如何？2、马来西亚新厂整体进度如何，是否有明确的投产节点？3、针对当下比较火热的内存芯片及CPO光模块概念，贵司是否有相关的业务拓展规划以争取一定的市场红利？4、最后，针对以色列的地缘政治动荡情况，贵司控股的以色列氮化镓相关业务是否存在相

关风险？谢谢！

回答：公司目前生产与产能利用情况正常。

马来西亚生产基地正处于厂务系统及无尘室装修施工阶段，生产工艺与设备选型、团队组建与培训等工作正在同步开展，预计年底进入打样试生产阶段。

公司专注于集成电路先进封装技术，尤其在晶圆级TSV领域具备显著领先优势，公司将密切关注晶圆级TSV等工艺在堆叠、光电共封、光电互联等领域的应用潜力，积极推进技术能力创新与市场应用拓展。

近年来，为有效应对国际贸易与产业重构发展趋势，更好贴近海外客户需求，巩固提升公司产业地位，公司积极推进全球化发展战略，包括您提到的投资以色列VisIC公司。公司将密切跟踪地缘政治与国际局势趋势，通过股权架构优化、协同战略合作伙伴、本土化运营融入、资产证券化等多元化举措，保障海外投资的安全与经营成果。

问题5：请问，马来西亚生产基地什么时间投产。

回答：相关问题请见前述回复，谢谢！

问题6：请问，战争对以色列工厂的影响。

回答：您好，目前公司投资的以色列公司生产经营一切正常，公司将密切跟踪地缘政治与国际局势趋势，通过股权架构优化、协同战略合作伙伴、本土化运营融入、资产证券化等多元化举措，保障海外投资的安全与经营成果，谢谢！

问题7：请问，2025年度分红安排有了吗？方便介绍一下吗？

回答：您好，公司秉承积极回报股东的战略，每年按照当年度净利润的比例积极实施现金分红，公司2025年的分红方案拟为：以2025年末公司总股本为652,171,706股，其中以集中竞价回购产生的库存股747,700股，2025年度利润分配拟以扣除集中竞价回购产生的库存股后的股本651,424,006股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计人民币78,170,880.72元。分红具体安排将在股东会审议通过后予以实施。

问题8：请问，国内电动车销量下降，对2026年公司业绩的影响有多大，公

司有没有应对的措施，2026年Q1的订单量同比增加还是下降。

回答：整体来看，未来汽车智能化的水平将持续快速发展，对CIS等智能传感器产品的市场需求将有效增加，公司作为全球智能传感器领域先进封装技术的领先者，将通过技术的持续创新、生产能力的有效布局，积极把握市场机遇。2026年以来，公司的生产经营保持正常，感谢您的关注！

问题9：请问，公司如何应对上游材料价格上涨以及国内同行加速布局先进封装挤压市场份额对可能的盈利空间压缩？行业技术路线如转向非TSV技术，公司是否有应对技术储备？

回答：您好，公司专注于集成电路先进封装技术服务，为晶圆级TSV先进封装技术的领先者，公司不断通过技术工艺的迭代、生产效率的提升来应对您所提到的材料价格波动与行业竞争格局变化，应对成效较为显著，根据2025年年报显示，公司2025年营收同比增长30.44%，归母扣非净利润同比增长51.60%，经营活动产生的现金流量净额同比增长36.13%，毛利率提升到47.84%。随着AI技术的快速发展，AI芯片、自动驾驶、数据中心等新兴应用场景正不断对先进封装技术创新提出新需求，尤其是需要封装技术在有限空间内提供高密度互联方案。公司作为晶圆级TSV封装技术的领先者，未来将继续密切关注产业动态与市场需求，积极加强技术储备、推进技术能力创新与市场应用拓展。

问题10：请问，车载激光雷达与摄像头之间是否存在替代关系？有没有评估过华为896线激光雷达带来的进步会否挤压车载摄像头市场？

回答：您好，CIS、激光雷达等产品的创新发展，协同推动了汽车智能化的发展。随着汽车智能化水平的持续提升，对CIS、激光雷达等产品的市场需求将有效增加，公司将通过技术工艺的持续创新迭代，不断巩固拓展CIS、激光雷达产品市场需求，有效把握市场机遇。

问题11：请问，当下很多半导体上下游都进行了提价措施以应对各个供应链环节的资源涨价等现象，请问贵司是否已经产生了提价措施或者正在打算产生相应的提价应对措施？

回答：您好，公司将会密切关注市场动态，协同客户优化调整产品定价策略，顺应产业发展趋势，感谢您的关注！

三、其他事项

关于本次业绩暨现金分红说明会的具体内容，详见价值在线路演中心（网址：<https://www.ir-online.cn/>）。

感谢各位投资者积极参与本次业绩暨现金分红说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2026年3月11日